

 社長メッセージ

市場動向や顧客ニーズを的確に捉え、瞬発的対応力による柔軟な経営を目指します。



事業環境・業績

2011年度の世界経済では、米国の景気回復が遅れたことに加え、長期化する欧州の財政不安の影響を受け、先進国を中心に減速傾向が見られました。国内では、東日本大震災の復興が進む一方で、歴史的な円高の進行や、タイの洪水被害などの影響により、経済の回復は緩やかなものとなりました。このような中、当社が主力事業を展開する半導体業界においては、スマートフォンをはじめとする一部製品の需要が年間を通じて旺盛だったものの、パソコンや薄型テレビなどの販売は低迷し、全体では半導体部品の供給過剰状態が続きました。下期には在庫量の適正化のためにメーカー各社が設備投資を抑制する動きも見られましたが、期末にかけてアジア地域の一部で先端技術への投資活動が積極的に行われました。

このような事業環境において、当社で

は電子部品やメモリ、イメージセンサなどのスマートフォン関連デバイス向けの製品出荷が好調に推移し、売上高は2010年度、2007年度に続く過去3番目の高い水準(892億円)となりました。また、歴史的な円高の影響を受けたものの、生産現場での改善活動や事業環境に合わせた経費コントロールに努めたことから、粗利率(GP率)は46.6%となり、前年度に対し小幅な減少に留まりました。

半導体市場の回復

国内外の経済見通しは依然として不透明なもの、半導体業界においては2012年度もスマートフォン・タブレット端末の需要が堅調に推移すると見込んでおります。調整局面にあった半導体部品の在庫水準は改善され、OSAT(後工程受託メーカー)を中心にアジア地域全体で設備投資活動が活発になってきています。最終製品では、一般照明用LEDの量産が本格化

するほか、新しいOSや超薄型PCの市場投入などにより需要の拡大が期待されます。また、新たな技術として、裏面照射型CMOSイメージセンサやモバイル向けDRAMなどへの採用が拡大されていくTSV(3次元貫通電極)技術の進展と、その量産化へ向けた動きにも注目しています。

当社では、このような事業見通しに基づき、2012年度の売上高を957億円(過去2番目の水準)と予測します。今後も顧客のニーズに対応できる生産体制の拡充を図っていくとともに、積極的な研究開発活動に取り組み、高度なKiru・Kezuru・Migaku技術に一段の磨きをかけてまいります。株主の皆様におかれましては一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2012年6月

代表取締役社長 関家一馬

カッティングエッジ

CUTTING EDGE

73期事業のご報告

2011年4月1日～2012年3月31日



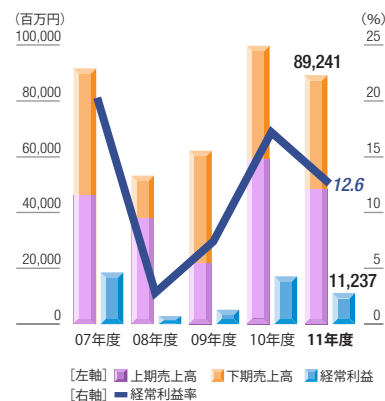
DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

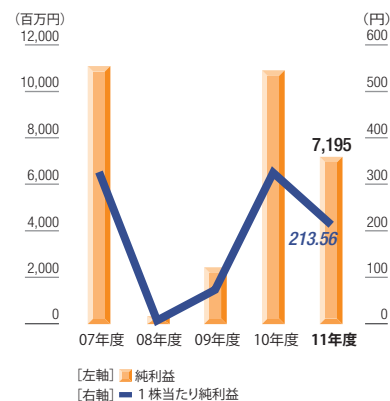


▶ 財務ハイライト

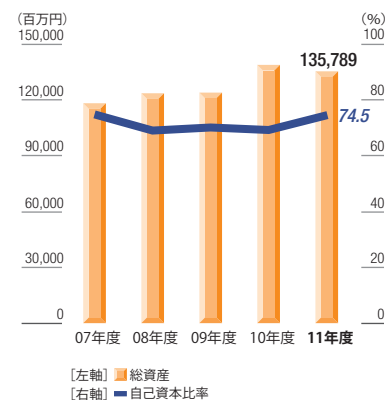
売上高 / 経常利益 / 経常利益率



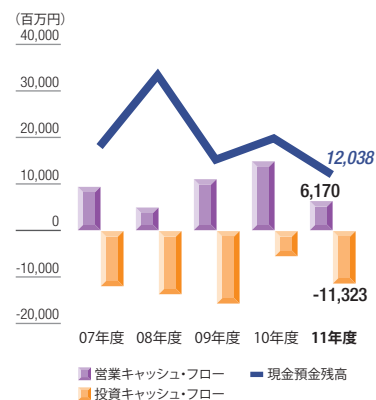
純利益 / 1株当たり純利益



総資産 / 自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2011年4月1日から2012年3月31日まで)の半導体業界や電子部品業界では、スマートフォンやタブレット端末などの一部の製品需要が旺盛だったものの、全体では半導体の供給過剰状態が続いたため、下期になると半導体メーカー各社が在庫の適正化のために設備投資を抑制する状況となりました。このような中、精密切断装置では、スマートフォン用電子部品向けが堅調な出荷となった一方、2010年度の牽引役であったLED向けレーザーの販売が不振だったことから、売上高は前期比2割減となりました。精密研削・研磨装置では、DBG※プロセスが業界に広く浸透し、量産が第4四半期に本格化し出したものの、その売上高は好況であった前期には届かず1割減となりました。精密加工ツール(消耗品)の売上は高水準で推移したものの、メーカー各社の生産調整や円高の影響を受け、前期比微減となりました。

これらの結果、当期の業績は売上高892億41百万円(前期比10.5%減)、営業利益106億61百万円(同33.0%減)、経常利益112億37百万円(同34.6%減)、純利益71億95百万円(同34.3%減)となりました。

※DBGプロセス：Dicing Before Grindingの略。薄化されたウェーハを安全かつ高品質にチップ化する方法

■ 財政状態について

当期末の総資産は1,357億89百万円となりました。前期末からの主な動きとしては、たな卸資産や有形固定資産が増加した一方で、法人税の支払いなどによって現預金が減少しました。負債は332億53百万円となり、前期末と比べ支払債務や未払法人税などが減少しました。

純資産は1,025億36百万円となり、自己資本比率は74.5%(前期末比5.1ポイント増)となりました。

■ キャッシュ・フローの状況について

営業活動では61億70百万円の資金収入、投資活動では113億23百万円の資金支出となったことから、フリー・キャッシュ・フローは51億52百万円の資金支出となりました。これは、精密加工ツール新棟やシンガポールオフィスの建設などの設備投資費用が主な要因です。財務活動での22億18百万円の資金支出は主に配当金の支払いによるものです。これらの結果、当期末の現金及び現金同等物残高は、前期末から77億92百万円減少し、120億38百万円となりました。

次期の見通し

スマートフォン関連デバイスの需要は旺盛で、半導体メーカー各社の設備投資は比較的高い水準で推移するものと思われます。精密切断装置はLED向けを中心にレーザーが回復し、精密研削・研磨装置では薄化用ハイエンド機が伸長する見込みです。また、精密加工ツールも前期から5%程度の成長を見込んでいます。

これらの結果、売上高は7.2%の増収、純利益は30.6%の増益を予想しております。

2012年度 連結業績予想 (金額の単位：百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
95,700	13,600	13,800	9,400	278.95円



積極的な利益還元に向けて

配当性向を引上げ

当社は、株主の皆様への利益還元重視の姿勢を明確にするため、2006年度より業績連動型配当政策を導入し、配当性向は20%としておりました。

その後、当社を取り巻く事業環境は円高による収益の圧迫はあるものの、過去と比べて売上高の水準が上がっていることや、BCM*対応などを目的とした大型の設備投資が一段落したことなどにより、キャッシュ・フローベースでは以前よりもキャッシュを創出しやすい環境になってきました。

こうした状況を踏まえ、当社では株主の皆様へより積極的な利益還元を行うため、配当政策を変更し、当期の期末配当より配当性向を25%へ引上げました。

※BCM：Business Continuity Management
事業継続管理

次期の配当は増配見込む

当期の配当は、中間配当が29円、期末配当は今回変更した配当政策に基づいて19円(年間48円)とさせていただきます。

次期の配当は、業績予想に基づき、1株当たりの中間配当は36円、期末配当は35円(年間71円)を予定しております。

今後も、株主の皆様へ、より積極的な利益還元を行っていく所存です。

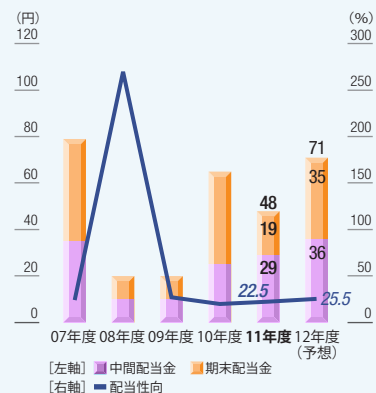
配当政策

1. 中間での配当総額は上期(4-9月期)連結純利益の25%、期末での配当総額は下期(10-3月期)連結純利益の25%といたします。
2. ただし、利益水準に関わらず安定配当として、半期10円の配当金を維持いたします。これにより年間の最低配当は20円となります(3期連続連結純損失の場合を除く)。
3. また期末時点で赤字の場合を除き、配当および法人税等支払い後の現預金残高が予定必要資金額*を超過した場合には、超過金額の3分の1を目処に上乘せいたします。

*技術資源購入資金(技術特許購入、ベンチャーへの出資等)および設備拡張資金、有利子負債返済資金など

[補足] これまで設けていた「連結業績において4年累計で売上高経常利益率が20%以上を達成した場合、連結当期純利益の24%を配当性向に適用する」という項目は、今回の配当性向引き上げに伴い廃止いたしました。

配当金 / 配当性向



免震構造棟で精密加工ツールの生産を開始 — 呉工場 新棟 竣工

BCM対応能力の向上

呉工場では、多くのお客様に日々ご使用いただいている精密加工ツールを製造しております。そのため、万が一当社からの製品供給が滞った場合、お客様の生産に多大な影響を及ぼす可能性があります。今回以下の設備を導入することにより、地震災害などによる被害を最小限に抑え、より安定した製品供給を実現する環境を整えました。

●免震構造の採用

新棟建設により、呉工場で作られる全ての精密加工ツールは免震構造棟での生産となります

●太陽光発電設備(約150kW)・コジェネレーション*設備の導入

災害時の最低限の電力需要に対応できる動力を確保できます

生産能力と効率性の向上

今後、精密加工ツールの更なる需要が見込まれるため、既存棟の1.25倍の生産面積を確保し、分散した旧工場棟の統合によって生産効率の向上を図りました。



名称：呉工場C棟

竣工日：2012年1月27日

建屋構造：免震構造

延べ床面積：約15,000m²(地上7階)

投資総額：約30億円

*コジェネレーション：

発電時の廃熱などを用いて、電力と熱を供給し、エネルギーの効率的利用を図るシステム

シンガポールオフィスの新社屋 建設

現地密着で顧客ニーズに対応

拡大を続ける東南アジア市場において、お客様のニーズが多様化してきていることから、シンガポール拠点に地上6階建ての新社屋を建設いたします。この新社屋は、アプリケーション施設やR&D施設、研修施設を有しており、旧社屋に比べ6倍以上の延床面積となっています。このように複数の機能を一箇所に集約させ、お客様に迅速かつ正確なソリューションの提供をすることで、更なるサービスの向上を図ってまいります。



名称：DISCO Hi-TEC Singapore One-stop Solution Center

竣工日：2012年7月

建屋構造：RC造

延べ床面積：約10,000m²(地上6階)

投資総額：約20億円



投資家の皆様からの疑問・質問にお答えします。



製品競争力をどのように維持していくのですか

秘策があるわけではなく、製造コストの低減に努め、生産性を向上させていくことに尽きると考えています。加えて、製品の信頼性や性能、ワールドワイドに対応できるサービス力から得られる長期的なメリットをお客様にご理解いただき、当社の製品を選択してもらえるような営業活動を行ってまいります。



高シェアを保つための施策とはどのようなものですか

お客様が求める『加工結果』を実現するために、最適な精密加工装置・精密加工ツール・加工レシピをパッケージとして迅速に提供し、当社製品の付加価値性を訴求していきます。また、新たなテーマについて「まずディスコに相談しよう」と思われるような圧倒的な信頼関係を築き、先端技術の新プロセスへ確実に対応できている状態を目指します。その一方で、地震や洪水などの自然災害に直面した場合に、当社の製品が供給不可能にならないよう、工場建屋の免震構造化や、生産体制の復旧プログラム策定により、お客さまに一社購買によるデメリットを感じさせない体制を構築しています。



M & Aなどを検討していますか

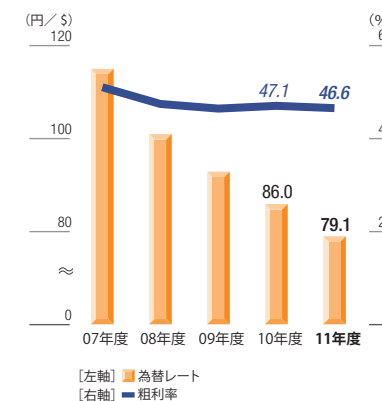
当社は『高度なKiru・Kezuru・Migaku技術』という事業領域を変えるつもりはなく、ここに絞り込んでいるからこそその競争力だと自負しております。よって、シェアの拡大や売上規模を伸ばすために他分野でM&Aを行うようなことはありません。ただし例外として、半導体製造プロセスの複雑化に伴う周辺技術の進展に対応し、競争力を維持するために、技術特許の購入やベンチャー企業への出資などを行う可能性はあります。



円高による影響と、これに伴った生産拠点の海外移転を検討していますか

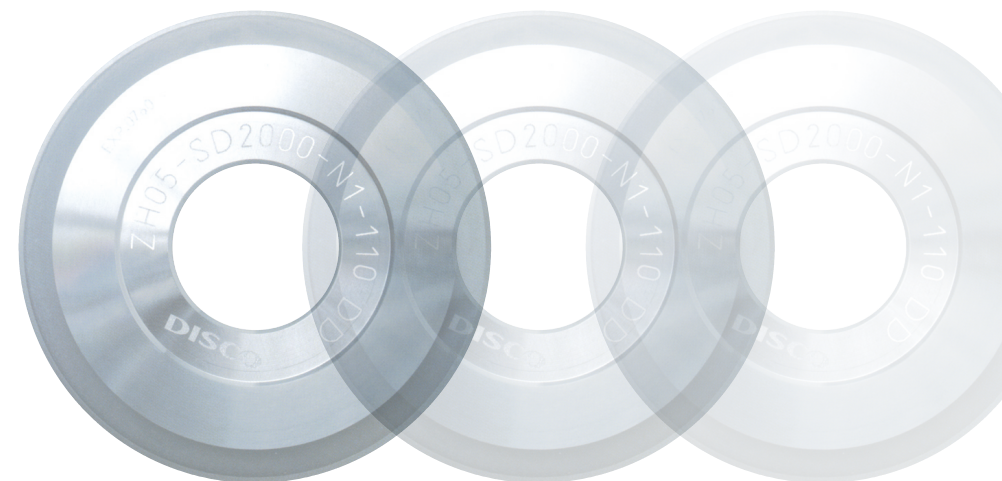
当社は基本的に円建てでの取引をお願いしておりますが、お客さまの要望により米ドル建てでの取引を行う場合があります。このため、米ドルの為替相場の変動は売上高と利益に影響を与えることとなり、その為替感応度は1円当たり年換算でおおよそ4億円となっています。こうした現状から、現在の為替水準（2011年度 実効レート：79.1円/\$）では、経費削減や原価低減などにより本来は利益に上乗せされる部分が、円高によって全て相殺されている状況です。しかし裏を返すと、この歴史的な円高水準にあっても当社は利益を出せる企業体質になっている、という見方もできます。今後においては、為替水準が現状と同程度であれば、生産現場の自動化を推進し、原価低減などのコスト削減策を継続実施することで、生産拠点を海外に移転させることなく、収益を更に改善できる状態になれると考えています。また、工場を国内に存続させるメリットとして、優秀な人財を豊富に確保できることや、高品質な部品供給を柔軟に得られることなどが挙げられます。その一方で、仮に海外での生産に移管した場合には、人財の分散や技術ノウハウの流出などが懸念されます。これらの理由から、当社はこれからも国内での生産を続けていく所存です。

粗利率（GP率）と為替レートの推移





「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」



3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評定されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができていくか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。